

公司代码：603316

公司简称：诚邦股份

诚邦生态环境股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 **董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

2025年4月29日公司第五届董事会第十二次会议审议通过公司2024年度利润分配方案，鉴于公司2024年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司2024年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚须提交2024年度公司股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诚邦股份	603316	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	余书标
联系地址	杭州市之江路599号
电话	0571-87832006
传真	0571-87832009
电子信箱	ir@cbgfcn.com

2、报告期公司主要业务简介

目前公司主营业务涵盖生态环境建设业务和半导体存储业务两大业务板块。

（一）生态环境建设业务

中国政府在第七十五届联合国大会上提出“2030 碳达峰、2060 碳中和”的目标。“十四五”规划提出了“常住人口城镇化率提高到 65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”的经济社会发展主要目标。2024 年中国城镇化率为 67%，和发达经济体 80%左右的水平相比，还有十几个点的提升空间，中国的城镇化仍然处在持续发展过程中。我国加强生态环境治理体系和治理能力现代化建设之路方兴未艾，公司所属行业成长空间广阔。但是，由于地方政府受房地产行业下行等因素影响，地方财政资金紧张，加之国家加强了对地方政府债务的清查和整顿，部分地方政府减少了市政园林相关建设投资，客户支付能力下降，致使项目结算进度放缓、收益下行，机遇与挑战并存。

公司拥有多年的生态环境设计、投资、建设及运营的经验积淀，依托上市公司品牌价值和平台优势深耕主业、稳健经营，公司在行业地位与品牌口碑等方面得到广泛认可。公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级等施工资质，业务扎根长三角地区，并涉足全国多个地区。

公司制定了清晰的发展战略，在稳步发展原有生态环境建设业务的基础上，以半导体存储业务作为创新突破业务，横向拓宽业绩增长点，打造“生态环境建设+半导体存储”双主业发展格局，通过进一步优化业务结构，不断提升行业地位和核心竞争力。

（二）半导体存储业务

1. 半导体存储产业概况

半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，根据功能的不同，集成电路又可以分为存储器芯片、逻辑芯片、模拟芯片、微处理器等细分领域。存储芯片是现代电子设备中不可或缺的部分，其通过半导体电路存储二进制数据，广泛应用于内存、固态硬盘、U 盘及各种消费电子产品中。存储芯片根据用途的不同可分为主存储芯片和辅助存储芯片，而它们又按照数据在断电后的保存方式分为易失性存储（如 DRAM 和 SRAM）和非易失性存储（如 NAND 和 NOR 闪存）。

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据，2024 年全球半导体行业的整体规模达到 6,276 亿美元，比 2023 年增长 19.1%。存储市场有望实现超过同比 81%的高增长，达到 1,670 亿美元，占整个半导体市场规模的 26.61%，是半导体产业的核心分支。预计 2025 年全球半导体市场仍将

实现增长，市场规模将达到 6,971 亿美元，同比增长 11.1%。据全球知名市场研究机构 Yole 发布的报告显示，2027 年存储市场空间预计增长至 2,630 亿美元。

2. 公司所处半导体存储产业发展的主要驱动因素

(1) AI 大模型快速发展，对存储需求不断提升

DeepSeek-R1 的开源及在国内的爆火，促使众多国内厂商和公司竞相接入、部署相关模型，有力推动了国内 AI 产业的快速发展。与此同时，像 Chat GPT、Gemini、Claude、Grok、豆包、元宝、通义等众多 AI 模型持续更新迭代，使得对算力以及存储的需求不断攀升。美光曾表示，AI 服务器对存储器的需求远高于普通服务器，其所需的 DRAM 是普通服务器的 8 倍，NAND 则是普通服务器的 3 倍，受此影响，服务器存储市场规模正不断扩大。

(2) 目前存储器国产化率较低，但技术突破与政策支持正加速国产化进程。

根据 TrendForce 集邦咨询数据，2024 年第三季度包括长江存储在内的国产 NAND 厂商市场份额只有 4.1%，国产 DRAM 芯片市场份额低于 5%。但长鑫存储 16 纳米 DDR5 芯片已量产，长江存储 Xtacking 架构实现了全球领先的 3D NAND 技术突破，预计 DRAM 及 NAND 领域的国产化进程将持续加速，为国内独立存储器厂商的发展带来了更多的契机。

(3) 终端设备迭代升级对存储容量及性能的需求持续攀升

半导体存储产业链的下游应用场景极为丰富，覆盖了从个人消费电子到数据中心的广泛领域。智能手机、PC、可穿戴设备等消费电子产品的迭代升级，以及数据中心、云计算、自动驾驶、物联网等新兴技术的快速发展，推动数据规模持续增长。根据灼识咨询数据，每年生产的数据总量从 2013 年的约 10ZB 增至 2023 年的约 130ZB，到 2028 年将达到近 400ZB，数据规模持续增长为半导体存储产业发展提供了长期动能。

目前公司主营业务涵盖生态环境建设业务和半导体存储业务两大业务板块。

(一) 生态环境建设业务

1、公司主要业务

公司是目前国内同行业中资质最齐备的企业之一，经过多年不懈努力和探索，在项目承接、建设及运营管理方面积累了较为丰富的经验，在生态环境项目投资、建设、运营能力等方面具备较强优势。

鉴于公司全资子公司诚邦设计集团业务近几年连续亏损，为聚焦公司核心业务发展，优化资源配置，提高公司资金和资源利用效率，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司将诚邦设计集团 100% 的股权转让予

公司关联方方利强先生。报告期内，除了剥离亏损的设计业务，公司生态环境建设业务内部的构成没有发生重大变化。

2、公司经营模式

公司经营业务主要分为销售（项目承揽）、采购、实施及结算等环节。

（1）业务承揽模式：

公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务。公司设立经营管理中心，与公司相关事业部相衔接，通过公开信息及招标单位邀标等方式获取市场信息，首先对有意向的项目进行充分的尽调，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和投资收益。公司设立投标委员会，根据经营部门前期获得的项目综合信息，经过公司投标委员会分析和研究后，做出是否参与市场竞标的决策，以有效控制项目风险。

（2）采购模式：

公司成本管控中心负责对供应商进行筛选和考核，并建立合格供应商库，对供应商的资信能力、生产实力、管理能力等进行综合评估后纳入合格供应商库。公司采购主要分为大宗材料、劳务采购、就近采购材料及零星材料等类别，大宗材料和劳务采购通常通过询价与招标相结合的方式进行，对于项目上急需的材料或零星材料一般经采购中心授权后就近采购。

（3）实施及结算模式：

针对 EPC 项目及一般工程项目。公司与业主单位签订合同后，工程管理中心根据项目内容进行统筹管理和任务分配，组建项目部具体负责项目的实施。公司与业主单位之间按合同约定的结算付款条件进行结算和付款，一般按月或分阶段支付工程进度款，工程竣工验收合格、经审计并办理工程竣工决算手续后支付大部分工程款，剩余部分款项作为工程质保金，于质保期内分期支付或质保期结束时一次性支付完成。

针对 PPP 项目。中标社会资本方与发包方签订《PPP 项目合同》后，由中标社会资本方与政府合资设立项目公司（SPV），通过项目公司对 PPP 项目进行投资、建设和运营。若公司负责资质范围内的项目施工，则公司将与项目公司签订《建设工程施工合同》，工程施工结算会根据《PPP 项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付。

（二）半导体存储业务

1、主营业务

公司下属控股子公司芯存科技主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，是国家高新技术企业。报告期内，公司已量产并销售的主要产品为移动存储（包括 TF CARD 、

USB 模块等)、固态硬盘 (包括 SATA SSD、PCIe SSD、PSSD) 等。期后, 芯存科技整合了包括芯源科技在内的相关业务资源, 致力于构筑芯片封测、存储模组产品研发生产一体化的经营模式, 布局嵌入式存储、内存条等产品, 打造完善的闪存存储产品矩阵, 在存储介质特性研究、固件算法开发、存储芯片封测、测试研发等方面打造综合竞争力。

2、主要产品或服务

芯存科技主要产品为半导体存储器, 主要包括固态硬盘、移动存储、嵌入式存储等。相关产品广泛应用于消费电子、移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域。公司未来将重点投入可用于大数据中心和服务器的企业级 SSD 等相关产品开发。

(1) 固态硬盘

固态硬盘可以满足大容量存储应用场景需求, 固态硬盘产品能够显著提升台式机、个人和商用电脑的性能。固态硬盘主要包括 SSD (固态硬盘)、PSSD (移动固态硬盘) 等产品形式, 被广泛应用于 PC、数据中心、人工智能、工控、安防、网络终端、医疗、航天、军工等诸多领域。公司目前拥有 M.2、2.5inch 等形态的 SSD 系列产品, 除 SATA 接口外, M.2 覆盖 SATA3、PCIe 两种协议接口。产品采用原厂提供的优质 NAND Flash 资源, 结合定制化高性能主控和自主固件, 在保证兼容性和稳定性的同时, 也可实现各类客制化需求。

产品分类	图示	具体产品	应用领域
固态硬盘		PCIeGen4x4M.2SSD	台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、POS 机, 广告显示屏
		PCIeGen3x4M.2SSD	台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、POS 机, 广告显示屏、网络通信、数据中心
		SATA3M.2SSD	台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、网通设备、工业电脑、工业平板、医疗设备、广告机
		SATA32.5-inchSSD	台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、POS、广告显示屏、工业电脑、NVR (网络视频录像机)、NAS (网络附属存储器)
		移动固态硬盘	数据备份

(2) 移动存储

1) 存储卡模组

存储卡是一种利用闪存技术存储数据信息的存储器，其尺寸小巧，外形多为卡片形式，主要应用于手机、GPS 设备、数码相机、无人机、安防摄像头、智能音箱、电子游戏机等消费电子产品中作为存储介质。公司存储管理应用方案广泛支持三星、铠侠、西部数据/闪迪、海力士、长江存储等各家存储原厂的相关存储晶圆产品。

2) 存储盘模组

存储盘（U 盘）是一种通过 USB 接口进行数据传输，利用 NAND Flash 存储芯片进行存储的可移动数据存储装置。公司存储盘模组产品方案具有较好的性能和成本优势以及广泛地支持三星、铠侠、西部数据、海力士、长江存储等各家存储原厂的相关存储晶圆产品。

产品分类	图示	具体产品	应用领域
移动存储		U 盘/USB 模块	数据存储、监控设备、电脑、平板消费级场景等
		存储卡	手机、车载应用、中控导航、无人机、相机、监控设备、视频播放器、数据备份、灾备盒、部标机

(3) 嵌入式存储

嵌入式存储广泛应用于智能终端，如智能手机、平板、智能电视、机顶盒等，近年随着智能网联汽车蓬勃发展，自动驾驶辅助系统（ADAS）、智能车载娱乐系统（IVI）、行车记录仪（DASH-CAM）等车用设备也成为嵌入式存储的主战场。公司现拥有 LPDDR 等嵌入式存储产品线且有少量生产，目前已规划 EMMC 等产品线，布局车规、工规、商规等领域高耐久特性产品，深入应用场景以满足市场需求。

产品分类	图示	具体产品	应用领域
嵌入式存储		LPDDR	智能手机、平板电脑、超薄笔记本、智能穿戴
		EMMC	智能显示、机顶盒、投影仪、行车记录仪、流媒体后视镜、智能家居、车机

3、主要经营模式

(1) 盈利模式

集成电路行业经过多年发展，英特尔、三星、德州仪器等巨头逐渐形成 IDM (Integrated Device Manufacturing, 集成设备制造) 的经营模式，是指企业除了进行集成电路设计以外，同时也拥有自己的晶圆制造厂和封装测试厂，业务范围涵盖电路行业的主要环节。该模式对企业的技术能力、资金实力、管理组织水平以及市场影响力等方面都有极高的要求。随着芯片制造工艺进步、晶圆尺寸扩大、投资规模增长，集成电路行业趋向于专业化分工，越来越多的企业走向专业化的发展道路，只专注于集成电路的芯片设计、晶圆制造、封装测试三大环节中的某一环节。

公司紧密围绕半导体存储器产业链，构建了芯片封测与存储模组研发生产一体化的经营体系。公司依据市场需求精准定位，从上游供应商采购 NAND Flash 晶圆及芯片、DRAM 晶圆及芯片等核心原材料，并外购主控晶圆及芯片，对存储介质特性进行深度匹配研究，通过固件/软件/硬件协同优化与定制化测试方案开发，公司将原材料经 IC 封测及模组制造工艺转化为适配各类应用场景的半导体存储器产品，最终销售予下游客户。

(2) 研发模式

针对市场的不同需求进行产品设计、研发及原材料选型，根据客户或目标市场需求确定性能参数，选择控制器类型、NAND 闪存类型 (SLC/MLC/TLC/QLC) 及接口协议 (NVMe/SATA)。自行设计 PCB 载板布局，规划电源管理、信号传输路径，优化散热结构，提升芯片使用过程中的读写效率、尽可能的减少电性干扰。多层板设计 (通常 4-8 层)，确保高速信号完整性，如 PCIe 4.0 需阻抗匹配。编写配置参数，纠错码 (ECC) 等。此外，公司自研自产芯片测试架和成品测试架等测试设备和测试算法，缩短芯片老化测试时长，大幅提升生产效率。

(3) 采购模式

公司依据自身生产工序特性以及终端存储器产品的市场需求，精心构建了一套健全且高效的供应商采购体系。在存储模组类产品的生产流程中，所涉及的关键原辅料主要涵盖 NAND Flash 晶圆及芯片、主控晶圆及芯片、PCB 板以及各类电子料。为了确保原材料的质量与供应稳定性，公司采取多元化的采购策略，既直接与优质的材料供应商达成合作，又通过其代理经销商渠道进行采购，以此充分满足企业生产经营的原材料需求，并有力保障产品质量与供应的持续性。

(4) 生产模式

公司拥有芯片封测和模组制造两个生产模块，其中：芯片封测生产模块，主要进行从晶圆到

芯片的封装测试工序，包括固晶、打线、模压、切割、高温 RDT、测试等工序，主要用于移动存储、嵌入式存储产品的制造，并为模组制造生产模块提供 NAND Flash 芯片原料。

模组制造生产模块，公司采购原材料后，对存储介质开展特性研究与匹配，确保多型号方案的兼容性。通过固件/软件/硬件和测试方案开发适配各类客户典型应用场景，管理闪存的擦除、写入操作，提升读写性能和闪存使用寿命。在完成上述流程后，公司进行存储模组制造，将原材料生产成半导体存储器产品，销售给下游客户。公司存储模组生产主要进行烘烤、PCB 上线、锡膏印刷、SPI 检测、SMT 贴装、外壳组装及成品测试等工序，主要用于固态硬盘、移动存储等消费级存储产品的生产制造。在公司自有产能无法全部满足生产需求时，公司采取外协加工的方式，确保产品按时交付，保障生产计划的顺利推进。

自与客户签订订单始，公司启动生产流程。若无需备料，最短一周内即可完成货物交付；若需备料，整个备料及生产过程综合考量约为 30-45 天，届时可确保货物顺利交付。

此外，亦有部分客户委托公司向其提供存储模组加工服务，客户提供主材，委托芯存科技进行加工，由芯存科技提供辅材，按照上述生产流程进行生产加工，完工交货后向客户收取加工费。



（5）销售模式

根据半导体存储器行业特点及下游客户的需求，通常可采用直销与经销的销售模式。直销模式下，公司直接将存储器产品销售给终端客户；经销模式下，产品通过经销商销售给下游终端客户。芯存科技目前主要采用直销模式。货物交付客户后，通常给客户留有 30-60 天信用账期，亦有少量订单货到付款。

（6）管理模式

公司根据专业化运营的要求，构建了完善的公司治理体系，建立了全面覆盖研发、生产、采购、销售和管理的组织机构。公司通过制度体系的建设和完善，对日常经营实现了制度化、流程化和信息化的有序管理。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	2,728,965,152.75	2,868,347,835.73	-4.86	3,011,752,842.16
归属于上市公司股东的净资产	649,005,448.56	748,478,912.68	-13.29	856,569,328.08
营业收入	347,893,842.71	448,359,446.89	-22.41	799,734,936.77
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	346,105,461.59	445,411,468.10	-22.30	797,559,034.08
归属于上市公司股东的净利润	-99,473,464.12	-108,090,415.40	7.97	-55,391,888.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,756,523.35	-110,461,318.24	4.26	-65,973,989.54
经营活动产生的现金流量净额	67,225,173.54	83,236,293.01	-19.24	-298,199,284.99
加权平均净资产收益率(%)	-14.2361	-13.47	减少0.77 个百分点	-6.25
基本每股收益(元/股)	-0.3764	-0.41	7.32	-0.21
稀释每股收益(元/股)	-0.3764	-0.41	7.32	-0.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	50,784,765.77	46,718,945.59	40,003,784.31	210,386,347.04
归属于上市公司股东的净利润	-2,889,934.37	-2,428,203.95	-11,395,464.28	-82,759,861.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,330,111.44	-2,610,799.93	-11,860,911.18	-87,954,700.80
经营活动产生的现金流量净额	-6,535,392.93	11,672,304.15	67,453,760.95	-5,365,498.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					11,899		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					12,965		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
方利强	-13,213,200	78,272,222	29.62	0	质押	60,299,820	境内自然人
李敏	-13,530,316	22,648,684	8.57	0	无	0	境内自然人
宁波宁聚 资产管理 中心（有限 合伙）—融 通5号证券 投资基金	13,530,316	13,530,316	5.12	0	无	0	境内非国有法人
上海期期 投资管理 中心（有限 合伙）—期 期高地六 号私募证 券投资基 金	13,213,200	13,213,200	5.00	0	无	0	境内非国有法人
吴化文	1,500,057	3,000,057	1.14	0	无	0	境内自然人
张浩洋	1,452,800	2,476,500	0.94	0	无	0	境内自然人
王齐玉	2,190,800	2,190,800	0.83	0	无	0	境内自然人
郑国萍	2,130,700	2,130,700	0.81	0	无	0	境内自然人
上海富善 投资有限 公司—富 善投资— 安享专享1 期私募证 券投资基 金	1,816,800	1,816,800	0.69	0	无	0	境内非国有法人
黄晓晖	1,327,400	1,498,800	0.57	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致 行动的说明	自然人李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别持有公司 29.62%和 8.57% 的股份						
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024 年，公司管理层围绕公司战略和经营计划开展工作，进一步调整优化公司内部管理体系和组织架构，加强存量项目运营管理，加强成本费用管控和现金流管理，力求公司在复杂的市场环境中平稳发展。

（一）调整优化内部管理体系和组织架构

公司投资芯存科技进入半导体存储领域后，进一步调整优化现有管理体系和组织架构，精简

人员配置，同时强化各责任主体责任意识，强化全面预算管理，加强成本费用管控，降低各类成本费用支出。

公司进一步完善法人治理结构，诚邦总部主要承担战略规划、人力资源、财务管理等职能，统筹协调各子公司资源，促进业务融合，总部和各子公司之间相互支撑、协同运作。加强子公司绩效管理，由总部提供技术、人才和资金支持，经营层面由子公司自主经营，充分调动子公司的积极性和创造性，总部作为管理与职能中心、资源配置中心，实现公司整体经营管理效能的提升。

（二）剥离或注销部分亏损子公司，优化资源配置

鉴于公司全资子公司诚邦设计集团有限公司业务近几年连续亏损，为聚焦公司核心业务发展，优化资源配置，提高公司资金和资源利用效率，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司将诚邦设计集团 100% 的股权转让予公司关联方方利强先生。

鉴于公司下属全资子公司杭州鑫诚源投资有限公司、浙江诚邦绿化工程有限公司现已没有经营活动，为优化资产结构、降低运营成本，提高公司的整体经营和资金使用效率，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，授权公司管理层办理该子公司的注销事宜。

（三）稳步发展环境建设业务

公司目前具有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包二级等施工资质，经过 20 多年的磨砺，在环境建设方面积累了丰富的市场口碑。目前，公司业务已由传统的园林和市政施工向更综合的生态环境建设进行升级。针对存量项目，落实项目竣工验收、审计等各项收尾工作，积极争取各项目尽快回款。针对新项目拓展，努力开拓古典建筑、水环境治理、生态修复等领域的市场空间，优选项目，控制风险。针对在建项目，加强项目现场管理，严格把控工程质量关，强化现场管理人员品质意识，树立公司品牌形象。

（四）加强存量项目的运营管理

公司近几年在省内外投资建设的 PPP 项目均已进入运营阶段，公司组建项目运营管理团队，按项目运营绩效考核目标要求做好项目运营组织管理，有效控制运维成本，提高运维效率。

（五）投资半导体存储领域，促进公司转型升级

围绕公司在稳步发展生态建设业务同时拓展新兴产业的发展战略，2024 年 10 月，公司通过对芯存科技增资 5800 万元获取 51.02% 股权，切入半导体存储领域。芯存科技是一家专业致力于

半导体存储产品的研发设计、封装测试、生产和销售的国家高新技术企业，芯存科技纳入公司合并范围后，优化了公司的业务结构，为公司未来长远发展增添新动力。

报告期后，芯存科技已迁入新厂房，完成对东莞市芯源科技有限公司的设备和封测业务等相关资源的整合，形成芯片封测、存储模组产品研发生产一体化经营的模式。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用